

Title (en)
CONDUCTIVE POLYMER DEVICE.

Title (de)
BAUELEMENT AUS LEITENDEM POLYMER.

Title (fr)
DISPOSITIF A POLYMERE CONDUCTEUR.

Publication
EP 0490989 A1 19920624 (EN)

Application
EP 90914344 A 19900910

Priority
• US 9005102 W 19900910
• US 40473089 A 19890908

Abstract (en)
[origin: WO9103822A1] A melt-extrudable conductive polymer composition which contains a polymer, a particulate conductive filler and a particulate non conductive filler. When a standard strip heater is made from the composition and tested in a UL VW-1 test, it has comparable performance to a heater made from a second composition which is the same as the composition but which does not contain the non conductive filler. When tested in a standard arcing fault test, the standard heater will trip a fuse in less time than is required by the second heater, i.e. in less than 30 seconds. A preferred nonconductive filler is Sb2O3.

Abstract (fr)
Composition de polymère conducteur pouvant être extrudée en fusion, contenant un polymère, une matière de remplissage particulaire conductrice et une matière de remplissage particulaire non conductrice. Lorsque l'on fabrique un dispositif de chauffage à bandes normal à partir de la composition, et lorsqu'on l'essaie selon le test UL VW-1, il présente des performances comparables à celles d'un dispositif de chauffage réalisé à partir d'une seconde composition laquelle est identique à la première composition mais ne contient pas la matière de remplissage non conductrice. Lorsqu'on le teste selon un test de défaillance d'allumage normalisé, ledit dispositif de chauffage normal fait sauter un fusible en moins de temps qu'il n'en faut au second dispositif de chauffage, c'est-à-dire en moins de 30 secondes. La matière de remplissage non conductrice préférée est Sb2O3.

IPC 1-7
H01C 7/02

IPC 8 full level
H01B 1/20 (2006.01); **H01B 1/22** (2006.01); **H01B 1/24** (2006.01); **H01C 7/02** (2006.01); **H05B 3/14** (2006.01); **H05B 3/56** (2006.01)

CPC (source: EP KR)
H01B 1/20 (2013.01 - EP); **H01B 1/22** (2013.01 - EP); **H01B 1/24** (2013.01 - EP); **H01C 7/02** (2013.01 - KR); **H01C 7/027** (2013.01 - EP); **H05B 3/14** (2013.01 - EP); **H05B 3/146** (2013.01 - EP); **H05B 3/56** (2013.01 - EP)

Citation (search report)
See references of WO 9103822A1

Cited by
WO2016010756A1

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)
WO 9103822 A1 19910321; AT E187013 T1 19991215; CA 2066254 A1 19910309; CA 2066254 C 19991102; DE 69033364 D1 19991230; DE 69033364 T2 20000727; EP 0490989 A1 19920624; EP 0490989 B1 19991124; JP H05500884 A 19930218; KR 920704316 A 19921219

DOCDB simple family (application)
US 9005102 W 19900910; AT 90914344 T 19900910; CA 2066254 A 19900910; DE 69033364 T 19900910; EP 90914344 A 19900910; JP 51343390 A 19900910; KR 920700519 A 19920307